

## PSI

<b>GROUPE(S) CONCERNE(S)</b>	<b>NBS</b>
<b>REFERENCE COMTEAM</b>	<b>NBS-08-10</b>
<b>REFERENCE DANS RENATECH LIMS</b>	<b>P-13-00224</b>

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Porteur du projet (Nom, prénom)	Leichle, Thierry
Coordinateur TEAM (Nom, prénom)	Bourrier, David

<b>FINANCEMENT(S) DU PROJET</b>			
(Un projet peut avoir plusieurs origines préciser <b>TOUS</b> les supports)			
<b>ORGANISME</b> (ANR, Europe, Carnot, etc.)	<b>NOM DE L'APPEL</b> (Pnano, 7 <sup>ème</sup> PCRD, blanc, etc.)	<b>EOTP DU CONTRAT SUPPORT</b>	<b>POUR 2015 sommes à priori prévues pour les réalisations technologiques</b>
<b>ANR</b>	<b>Blanc</b>	<b>415861</b>	3000€

<b>BILAN</b>			
<b>En avance</b>	<b>A jour</b>	<b>En retard</b>	<b>Terminé</b>
	<b>X</b>		

<b>Raisons d'un éventuel retard</b>			
<b>Non démarré</b>	<b>Développements procédés</b>	<b>Disponibilité de personnel</b>	<b>Disponibilités d'équipements</b>

Complément à la demande Comteam 2015

2/3

**Quel que soit l'état du projet (même terminé) expliciter les développements effectués, les objectifs atteints, les objectifs à atteindre, les problèmes rencontrés, etc...**

## PROCEDES

### DESCRIPTION DES ETAPES DU(ES) PROCEDE(S) A VENIR (PROJET EN COURS) OU FINALISE (PROJET TERMINE) :

#### FABRICATION DE NANOCANNAUX PLANNAIRES:

- DOPAGE LOCALISE (AVEC MASQUE D'OXYDE OU IMPLANTE)
- GRAVURE DE MICROCANNAUX
- PRISE DE CONTACT ELECTRIQUE (METALLISATION)
- DISSOLUTION ANODIQUE (ELECTROCHIMIE)
- DECOUPE DES PUCES
- SCHELLEMENT DES CANNAUX PAR COLLAGE PDMS SUR COVERSIP/ANODIC BONDING

.

		NATURE PROCEDES Mettre une croix dans la ou les colonnes adaptées			NATURE DES TRAVAUX
		ETABLIS	DEVELO PPEMENTS	FORMATIONS (Nb personnes)	Préciser notamment la nature des verrous (Exemple : litho laser : réalisation de masques / photolithographie : procédés classiques / gravure plasma : gravures classiques + développement de la gravure nanométrique dans du polymèreXXx)
LITHOGRAPHIE LASER masques /Ecriture					
PHOTOLITHOGRAPHIE		x			
LITHOGRAPHIE ELECTRONIQUE					
TRAITEMENT THERMIQUE		x			
DEPOTS SOUS VIDE		x			
ELECTROCHIMIE	Croissances	x			
	Photolithographie moules	x			
GRAVURE HUMIDE KOH, TMAH					
GRAVURE PLASMA		x			
CHIMIE Attaques/ Nettoyages/ Divers		x			
JET D'ENCRE Procédés à développer					
EJM Durée (en heures étalonnages compris)					
NANO IMPRINT UV Procédés à développer					
IMPLANTATION		x			
ASSEMBLAGE	Montages de puces				
	Wafer Bonding, CMP, sérigraphie, ...	x			
CARACTERISATION Formations					